JA 0016552 JAN 1986

48601

(54) INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(11) 61-16552 (A)

(43) 24.1.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-134042

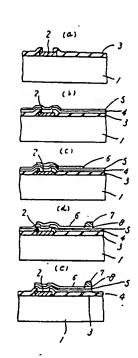
(22) 21.6.1985

(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) KEIJI MIYAMOTO

(51) Int. Cl⁴. H01L21/92

PURPOSE: To form a bump electrode easily at an arbitrary position on a semiconductor substrate, to which various elements are shaped, by constituting the titled integrated circuit device by the substrate, a wiring layer, an insulating film coating one main surface of the substrate except an electrode section, conductive layers of at least two layers, an uppermost layer thereof consists of a substance difficult to be wetted by solder, and a bump.

CONSTITUTION: A hole is bored to a protective film 3 on an electrode section in a wiring layer 2 formed onto a substrate 1. Plating foundation layers composed of two layers are shaped onto the whole surface on the substrate. A plating layer 6 shaped according to a pattern so as to tie a desired arbitrary bump forming position on the substrate and the upper section of the electrode section in the wiring layer 2 is shaped. A solder bump 7 connected to the plating layer 6 is formed by using a photo-resist mask. Since the plating layer shaped into an uppermost layer is not wetted by solder, the solder bump does not extend over the substrate due to wetting. Lastly, the plating foundation layers are removed selectively through etching while employing the plating layer 6 and the solder bump 7 as masks.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-116552

(43)公阴日 平成6年(1994)4月28日

(51)Int.CL⁸

識別配母

FAXPAT

FI

技術表示箇所

C 0 9 K 11/06 H 0 5 B 33/14 Z 9159-4H

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特題平4-264627

(71)出與人 000002174

梭水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天湖2丁目4番4号

(72) 発明者 島沢 剛信

茨城県つくば市二の宮4-8-3-3-

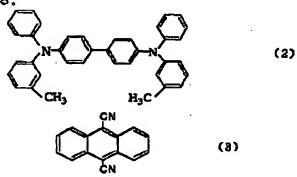
102

(22)出題日 平成 4年(1992)10月 2日

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 低電圧の条件下においても高輝度でかつ長期に亘り安定して発光する有機電界発光素子を提供する。 【構成】 陽極用透明電極が形成されたガラス基板の陽極用透明電極2面に、正孔輸送層、発光層、及び、除極用金属電極をこの順に稅層して成り、上記正孔輸送層が化合物(2)と化合物(3)との混合物で構成されている。



【効果】 上記混合物の適用により、機能発現に必要な 最低限の膜厚に設定してもピンホールを生ずることなく 正孔翰送暦3が形成されかつ正孔翰送効率を向上させる ことができ、10V前後という極低電圧の条件下でも高 輝度でかつ長期に買り安定して発光する有機電界発光素 子が得られる。

*上記正孔翰送層が下記一般式(1)で示されるいずれか

一方の化合物と下記一段式(2)で示される化合物との

混合物により構成されていることを特徴とする有機電界

特開平6-116552

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】2つの電極間に、正孔輸送層と有機色素よ り成る発光層とを備え、又は、正孔輸送層と電子輸送層 及びこれ等に挟まれた有機色素より成る発光層とを備え る有機電界発光素子において、

【化1】 (1)

(1) - b

死光索子。

式中のX社、CI,Br,CNを表す。

【化2】

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機色素より成る発光 層を備えた有機電界発光素子に係り、特に、10V前後 の極低電圧の条件下でも高輝度でかつ長期に亘り安定し て発光する有機電界発光素子の改良に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】電界発光素子は従来からよく知られてお り、一般には2つの電極間に正孔輸送層と発光層とを備 え、正孔翰送暦を通じて陽極電極から供給された正孔と 他方の陰極電極から供給された電子とが上記発光層と正 孔輸送層の界面で再結合して一重項励起子を生成し上記 発光層が発光するものである。

【0003】そして、上記電界発光素子の発光効率を高 めるためには、電子や正孔等の電荷注入効率、電荷輸送 効率、一重項励起子の生成確率、及び、一重項励起子の **発光遷移確率等を高めることが重要であり、例えば、陰** 極電極から電子を適切に発光層に輸送すると共に、正孔 輸送層から輸送された正孔が一重項励起子生成に関与せ ず発光層を透過して陰極へ移動することを防止する電子 輸送層を上記発光層と陰極電極の間に設け、一重項励起 子の生成確率を向上させて発光効率を高めた電界発光素 子も開発されている。

【0004】ところで、このような電界発光素子として は、従来、発光層に硫化セレンや硫化亜鉛等の無機系蛍 光体を用いた無機系の電界発光素子が一般的であった が、近年、発光層として有概色素を利用した有機電界発 光素子が提案されている。

【0005】例えば、特開昭59-194393号に記 **載された有機電界発光素子は、陽極上に、順次、正孔翰※50 め、製膜されたこれ等正孔翰送層や発光層の膜構造はア**

20※送層、有機色素より成る発光層、陰極を設けて構成さ

れ、両電極間に25V以下の低電圧を印加した場合に少 なくとも9×10-6 (W/W) に及ぶ電力転換効率 (人 力に対する出力の比で定義されシステムの駆動電圧の関 数)をもって発光するものであった。

【0006】また、特開半2-255789号公報にお いては上記発光層にナフタレン誘導体を適用することに より、また、特開平2~223188号公報では正孔翰 送材料と発光材料の混合物層若しくは電子輸送材料と発 光材料の混合物層を適用することにより発光効率や発光 **輝度などを改善した有機電外発光素子が開示されてい る.**

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、 これ等公報 に記載された有機電界発光素子においては、その発光環 度の初期値としてはいずれもほぼ十分な値を示している が発光輝度の安定性や発光寿命の点で十分な性能を示す ものは未だ得られていなかった。

【0008】そして、この原因は上記有機電界発光索子 の一部を構成する正孔輸送層の膜厚が本来の正孔輸送機 能を発現するために必要な膜厚よりも厚く設定されてい ることにあった。すなわち、上記正孔翰送層に適用され ている従来の材料では、その膜厚を薄く設定するとピン ホールを回避することが困難になるため本来の正孔輸送 機能を発現するために必要な胶厚より厚く設定せざるを 得なかった。従って、その分、正孔翰送層の抵抗値が高 くなるため駆動時における上記正孔輸送層からの発熱が 避けられなくなる。

【0009】他方、上記正孔輸送層や発光層等の製膜手 段としては、通常、蒸着法や温式法が適用されているた

モルファスである場合がほとんどであった。

【0010】このため、実用に値する輝度を得る程度の 印加電圧で生ずる上記正孔翰送層からの発熱に起因し て、構成材料である有機化合物が容易に動いてしまい最 適な膜構造を維持できなくなると共に上記有機化合物が 熱的ダメージを受ける弊害があった。

【0011】そして、これ等のことが原因となって電荷 の注入及び輸送効率が低下すると共に抵抗値が増大し、 駆動電圧の上昇及びジュール発熱の増大等の問題を引き 起こし、発光効率の低下や発光寿命の低下をもたらして 10 いた。

【0012】特に、上記正孔輸送層や発光層等の製膜手 段にキャスティング法やスピンコート法などの混式製膜 法が適用された場合、正孔輸送層を構成する製膜材料に はピンホールを回避するための結着材が混入されている ため電気抵抗値が更に高くなり、上配弊害が更に顕著に なる問題点があった。

【0013】本発明はこのような問題点に着目してなさ れたもので、その課題とするところは、低電圧の条件下 においても高郷度でかつ長期に亘り安定して発光する有 + 20 特開平6-116552

* 機電界発光素子を提供することにある。

[0014]

【課題を解決するための手段】この様な技術的背景の 下、本発明者等が低電圧で高輝度に発光し得る有機色素 について鋭意検討した結果、ある特定の2種類の化合物 から成る混合物を用いて上記正孔翰送層を構成した場 合、この正孔翰送層の膜厚について正孔翰送機能を発現 するために必要な最低限の膜厚に設定してもピンホール が生じないことを見出だし本発明を完成するに至ったも のである。

【0015】すなわち請求項1に係る発明は、2つの電 極間に、正孔輸送層と有機色素より成る発光層とを偏 え、又は、正孔翰送層と電子輸送層及びこれ等に挟まれ た有機色素より成る発光層とを備える有機電界発光素子 を前提とし、上記正孔翰送層が下記一般式 (1)で示さ れるいずれか一方の化合物と下記一般式(2)で示され る化合物との混合物により構成されていることを特徴と するものである。

[0016]

【化3】

式中のXは、CI,Br,CNを安す。

【化4】

本発明に係る有機電界発光素子においては、従来と同様 に、上記発光層を正孔輸送層と共に2つの電極で挟み、 この2つの電極から注入される正孔と電子を正孔輸送層 と発光層の界面で結合させて発光層を発光させる。従っ て、この2つの電極のうち正孔輸送層側に設けられる電 極は陽極用電極であり、他方、発光層側に配置される電 極は陰極用電極である。

【〇〇17】また、発光層から生じる蛍光を外部へ射出 するため、陽極側、陰極側のどちらでもよいが光を取出 す側については、基板材料、電極材料、電荷移動材料共 に発光波長が透過し得る透明性を必要とする。

【0018】上記基板材料としては、例えば、ソーダラ イムガラスや硼珪酸ガラス等のガラス基板、シリコンウ エハー若しくはポリカーポネート、アクリル、エポキシ 等の合成樹脂基板等が挙げられる。

【0019】また、上記陽極用電極としては正孔を効率※50

※よく注入できるものが好ましく、例えば、SnO2、I nO2、若しくはITO等の透明電極、あるいは企又は ニッケルから成る半週明電極等従来公知の電極材料がい ずれも適用可能である。

【0020】また、陰極用電極としては電子を効率よく 注入できる金属が好ましく、Mg、Al、Ag、In、 Li、Naなどに代表される仕事関数の小さな金属であ ればいずれも使用可能であり、真空黙着法やスパッタリ ング法により30mm以上の膜坪に製膜形成されるもの が好ましい。

【0021】一方、正孔翰送層は、電場を与えられた電 極間において陽極用電極からの正孔を遊切に効率良く発 光層へ伝達することができ、かつ、機能発現に必要な最 低限の膜厚でもピンホールを生ずることなく製膜可能な 低抵抗化合物により構成することができる。

【0022】そして、木発明においては下配一般式

特開平6-116552

5

(1)で示されるいずれか一方の化合物と下記一般式

(2)で示される化合物との混合物が適用され、好まし

くは真空蒸着法等の方法により5~60 nmの膜厚に形*

*成される. [0023] [化5] (1)-b

式中のXは、CI,Br,CNを安す。

[146]

また、上記発光層は可視光域に強い蛍光を示し、かつ、製膜性の良い有機化合物なら任意の材料が適用できる。例えば、ピレン、ペリレン、ペリレン誘導体類、ペリノン誘導体類、アントラセン、金属フタロシアニン類、無金属フタロシアニン類、ポルフィリン類等、従来公知の材料が適用可能であり、真空蒸若法等により3~100 nmの膜厚に製膜形成されたものが好ましい。

【0024】また、発光層から陰極用電極に正孔が移動することを防止すると共に陰極用電極から発光層へ電子を適切に注入して一重項励起子の生成確率を向上するため、発光層と陰極用電極の間に電子輸送層を設けることができる。このような電子輸送層としては、電場を与えられた電極間において、陽極からの正孔をブロックし、陰極からの電子を適切に陰極側へ伝達することができる化合物により形成することができる。

【0025】この電子輸送層に適用できる無機化合物としては、P(燐)がドーピングされたn型のアモルファスシリコン薄膜、若しくはCdS(n型)、CdSe(n型)、ZnSe(n型)等の化合物半導体薄膜が例示できる。

【0026】他方、有機化合物としては、例えば、アミノ基又はその誘導体を有するようなトリフェニルメタン、キサンテン、アクリジン、アジン、チアジン、チアソール、オキサジン、アゾ等の各種染料及び顔料、ペリノン系顔料、ペリレン系顔料、ペリレン系顔料、シアニン色素、2,4,7ートリニトロフルオレノン、テトラシアノキノジメタン、テトラシアノエチレンなどが適用できる。

【0027】そして、好ましくは真空蒸着法等の方法により5~70 nmの限序に形成される。

[0028]

【作用】請求項1に係る発明によれば、上記一般式

(1)で示されるいずれか一方の化合物と上記一般式 ※

※(2)で示される化合物との混合物により正孔輸送層が 構成されているため、機能発現に必要な最低限の膜厚に② 設定してもピンホールを生ずることなく正孔輸送層が形成され、かつ、正孔輸送効率を向上させることも可能となる。

【0029】従って、10V前後という極低電圧の条件下でも高速度でかつ長期に亘り安定して発光する有機電界発光素子を提供することが可能となる。

[0030]

【実施例】以下、本発明を実施例に従って更に詳細に説明する。

【0031】 [実施例1] この実施例に係る有機電射発 30 光素子は、図1に示すように松崎真空(株)製の硼珪酸 ガラス基板1と、このガラス基板1上に順に形成された ITO膜から成る陽極用透明電極2、正孔輪送層3、発 光層4、及び、金属マグネシウムから成る陰極用金属電 極6とでその主要部が構成されており、かつ、この素子 面積の大きさは0.25cm² (5mm×5mm)に設 定されている。

【0032】そして、上記正孔輸送層3は下記一般式

(3)で示された化合物と下記一般式(2)で示された 化合物との混合物により構成され、かつ、上記発光層4 40 は下記一般式(4)で示された化合物により構成されて いる。

[0033]

【化7】

【化8】

特開平6-116552

 $\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$

H₃C

[Æ9]

尚、上記陽極用透明電極2を構成するITO膜面内の抵抗値の平均値は100/sq.、正孔輸送層3の膜厚は50nm、及び、発光層4の膜厚は70nmに設定されており、かつ、素子面積は陰極用金属電極6の面積により規定した。

【0034】そして、図1に示すようにこの有機電界発 光素子の陽極用透明電極2と陰極用金属電極6の間に1 1Vの電圧を印加したところ、電流密度78mA/cm²を示し、570nmの波長にて輝度900cd/m²の発光を示した。

【0035】尚、この有機電射発光素子は以下のような方法で製造されている。

【0036】すなわち、まず松崎真空(株)製の硼珪酸 ガラス基板1表面のITO膜を15wt%の塩酸水溶液 で所望のパターンにエッチングして陽極用透明電極2を 30 形成し、かつ、純水で洗浄し、次いでエタノールの蒸気 洗浄を行い、クリーンオーブンで100℃×10Hrの 条件で乾燥した。

【0037】次に、上記正孔輸送層3は図2に示す真空 緊着装置を使用し、ボート加熱法により形成した。

【0038】すなわち、子めゾーンメルティング法により精製した上記一般式(3)で示された化合物と一般式(2)で示された化合物を使用し、これを熱電対付き加熱ボード11上に載置し、加熱して蒸発させ、順厚及び 然発速度検出用水晶振動子16により正孔輸送層3の膜 40 厚と蒸発速度を測定してシャッター14の開口率を制御しながらホルダー10aに固定されたガラス基板から成る順形成基板10のITO膜上に、一般式(3)で示された化合物と一般式(2)で示された化合物との混合物 から構成される正孔輸送層3を形成した。

【0039】尚、真空素若装置による共素若条件は以下 の通りである。

[0040]

背 圧: 5. 0×10⁻⁷torr. 以下

加熱 温度:170~190℃

* 蒸着レート: 一般式 (3) で示された化合物は0.3 nm/sec. 一般式 (2) で示された化合物は0.1 nm/sec.

> 次に、この図2の真空蒸着装置の真空をブレークすることなく、同じ真空蒸着装置内でポート加熱法により発光 図4を形成した。

> 【0041】すなわち、溶媒からの再結晶により符製した上記一般式(4)で示された化合物を蒸発源に用い、これを熱電対付き加熱ボード11上に截置して上記正孔輸送層3の場合と同様に膜形成基板10の正孔輸送層3上に発光層4を形成した。

【0042】真空蒸着条件は以下の通りである。

20 [0043]

加熱 温度:180~200℃

蒸着レート: 0. 1 nm/sec. ~1. 0 nm/se

最後に、この図2の真空蒸着装置の真空をブレークする ことなく、同じ真空蒸着装置内で電子線加熱法により除 極用金属電極6を形成した。

【0044】すなわち、純度99.99%のマグネシウムをBN製電子線加熱蒸若用るつぼ12に載置し、電子鉱13により加熱して蒸発させ、膜厚及び蒸発速度検出用水晶振動子17により陰極用金属電極6の膜厚と蒸発速度を測定してシャッター15の開口率を制御しながら、膜形成基板10の電子輸送層5上に陰極用金属電極6を形成した。尚、図中、18はマスクを示している。【0045】陰極用金属電極6の真空蒸着条件は以下の通りである。

[0046]

背 庄: 5. 0×10⁻⁷torr. 以下

フィラメント電流:30~35mA 蒸着レート:0.1nm/sec.~1.0

) 蒸着レート: O. lnm/sec. ~1. Onm/sec.

[実施例2]上記正孔翰送層3の構成材料として上記一般式(2)で示される化合物と下記一般式(5)で示される化合物との混合物を適用したことを除き実施例1に係る有機電界発光素子と略同一である。

【0047】 【化10】

特開平6-116552

9 (5)

FAXPAT

そして、図1に示す有機電界発光素子の陽極用透明電極 2と陰極用金属電極6の間に9.5Vの電圧を印加した ところ、電流密度70mA/cm²を示し、590nm の波長にて輝度930cd/m²の発光を示した。

【0048】 [比較例] 上記正孔翰送層3の構成材料として上記一般式(2)で示される化合物のみを適用した 10 ことを除き実施例1に係る有機電界発光素子と略問一である。

【0049】尚、真空蒸着条件は以下の通りである。

【0050】蒸着レート: 0.3nm/sec.

膜 膜:60nm

そして、実施例と同様に、図1に示された有機電界発光 素子の陽極用透明電極2と陰極用金属電極6の間に14 Vの電圧を印加したところ、電流密度42mA/cm² を示すと共に520nmの波長にて輝度500cd/m² 2の発光を示しており、実施例に係る有機電界発光素子 20 より劣っていた。

[0051]

【発明の効果】請求項1に係る発明によれば、機能発現 に必要な最低限の膜厚に設定してもピンホールを生ずる ことなく正孔輸送層が形成され、かつ、正孔輸送効率を 向上させることも可能となる。

10

【0052】従って、10V前後という極低電圧の条件下でも高輝度でかつ長期に亘り安定して発光する有機電界発光素子を提供できる効果を有している。

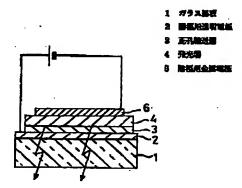
10 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例に係る有機電界発光素子の断面説明図。 【図2】実施例において使用した真空蒸着装置の説明

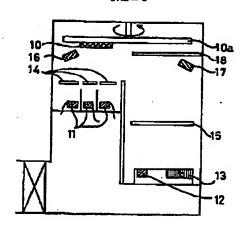
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 陽極用透明電極
- 3 正孔翰送層
- 4 発光層
- 6 陰極用金属電極

【図1】



【図2】



⊕ 公開特許公報(A) 昭61 - 16552

@Int,CI,4

推別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986) 1月24日

H 01 L 21/92

7638-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全2頁)

公発明の名称 集積回路装置

到特 照 昭60-134042

❷出 瞬 昭54(1979)3月30日

母特 顧 昭54-36871の分割

砂発 明 者 宮 本 圭 二 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

创出 顧 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

0代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

97 AG 🖶

発明の名称 集積回路装置

特許請求の範囲

- 1.(4) 諸県子の形成された半導体等板と
- (b)上記半導体基板上に形成された配益層と
- (c)上記配線層の電極部を抜く半導体基板の一主面を覆う熱機算と

(1)上記電極部とパンプ形成位置とを接続する上記絶職機上に形成された。一番上の層がハンダに 強れにくい物質からなる層である。少なくとも2 層からなる導管層と

- (c)上記パンプ形成位置に設けられたパンプとからなることを特徴とする集積回路設置。
- 2. 上記パンプは、その下に必要に応じたパンプ 下地層を持つことを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の集後回路装置。

発明の詳細な説明

本発明は集積回路装置に関する。ここでは特に 集積回路装置等の基板上の所望とする任意の位置 にはんだパンプ電弧を形成した集積回路装置につ

いて説明する。

はんだパンプ電極(通称CCB電極等)の形成された装置としては、通常、配施発了徒のウェハ にさらにSiO₂ 、Si₃N。あるいはポリイミド系ポリマー等からなる絶殺性の保護襲を形成し、所 優のパンプ形成位置における上配保護襲に欠あけ を施し、上配欠あけ部に適宜のパンプ下地襲を介 してハンダパンプを形成した集積回路装置が作られていた。

しかし、上述の如き従来の装置においては、パンプ位置を基板上の任意の位置に形成するために 多層配蓋構造とせねばならず。それだけ多くの工 数を要する欠点があった。

尚、保護師の穴あけ部に適宜のパンプ下地院を 介してハンダパンプを形成した典教回路機能については、特別昭54~113246号に記載されている。

本男別は、紀島岸上の電磁部に導通するはんだ ペンプ電磁を、基板上の任念の位置に容易に形成 することができる新娘な集積回路装置などを提供 する目的でなされたものである。

本発明の一実施例の収養は配慮層の電電部上の 保護機能大力けを施した後、全部に例えば下すと Cu等からなるメッキ下地線を形成し、その上に 高板上の所盤のペンプ形成位数と、前記配線層の 電電器とを始ぶようにペターン形成されたCェメ ッキ層を設け、次いで適宜のはんだ下地層、例え ばN 1 機を介して上記Cェメッキ層に接続しては んだパンプを形成し、最後に上記Cェメッキ層お よびはんだパンプをマスタとして残余のメッキ下 地層をエッチング絵会することを特徴とするもの である。

第1回向乃至向は本発明の一実施無様を示す工 役毎の関である。

まず回(s)の如く、基板1上に形成された配差層 2の電低部上における保護膜3に大おけを施す。 次に回(s)の如くT(膜4 およびC u 膜5 の二層 からなるメッキ下地層を基板上の公面に形成する。 次いで回(c)の如く、基板上の所領とする任金の パンプ形成位置と前記配差層2の電極部上とを前 ようにパターン形成されたCuメッキ層 6 を設ける。このためには、Cr/Cu/Tiの重ね膜を形成後、Crをホトエッチングでパターニングすればよい。

次に個似の如く、ホトレジストマスクを用いて パンプ形成位置においてCrメッキ層に接続する はんだパンプナセ形成する。ここで、上記ハンダ パンプは、例えばNi等からなるパンプ下地線8 を介して他記メッキ下地層上に形成される。

最後に図(c)の如く、Cェメッキ層 6 およびハン グペンプ?をマスクとしてメッキ下地層、即ちCu 属 5 およびTi属 6 を選択的にエッチ除去する。

上述の如き本発明の一実施無機によれば、数回 のメッキ処理およびエッチングによる導電層によ り基板上の任意の位置にはんだパンプを設けるこ とができ、単導体装置の小型化・高密度化を容易 にすることができる。

また。最上面に形成されたCェメッキ層は住んだに置れないため、ハンダバンブが差収上に置れ 広がることがない。しかも、パンブを基板上に分

飲して任意の位置形成しうるため、ポンディング の限の熱による熱質分等に対する寿命をのばすことができる。

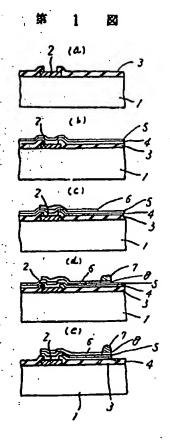
図面の簡単な説明

第1回(A)乃至(A)は本発明の一実施蓄機を示す工程毎の集積回路基板の断面図である。

1 …盖板、2 …配線層、3 …保護展、4 … T i 裏、5 … C n 業、6 … C r メッキ層、7 …パンプ、 8 … パンプ下地層(N i)。

代理人 弁理士 小川 勝 男





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.